

UNDERFILL FF35

CARACTERÍSTICAS

- Acción capilar de flujo rápido
- Se puede reparar y/o retocar.
- Compatible con residuos de flux no-clean.
- Baja generación de voids.
- Propiedades de Almacenamiento favorables.
- Cumple con la norma RoHS

DESCRIPCIÓN

Underfill FF35 es una resina epoxica de baja tensión superficial, diseñada para ser utilizada como relleno de flujo capilar para componentes flip chip, CSP, BGA y uBGA. La excelente acción capilar de Underfill FF35 forma una fina y extensa capa de unión bajo el componente. Underfill FF35 mejora la confiabilidad de la unión con una temperatura de transición vítrea alta T_g, y un coeficiente de expansión CTE bajo, con una excelente adherencia. Gracias a sus características de velocidad de flujo capilar y a su rápida acción de curado se obtienen rendimientos altos y mayor velocidad de en la producción. El relleno insuficiente de Underfill FF35 se puede reparar o retocar a 120°C (250°F). La viscosidad y el rendimiento del Underfill FF35 se mantienen estables durante toda su vida útil para facilitar su uso.

PROPIEDADES FÍSICAS

Parametro	Resultado
Apariencia	Amarillo claro
Gravedad Especifica	1.08 G/cc valor típico
Humedad	0.02% valor típico
% de Sólidos Volátiles	< 1% valor típico
Viscosidad a 25°C (77°F) a 5 RPM	500 cps valor típico
Índice de flujo Capilar	5 mm/1 min* valor típico
T _G	55°C valor típico
Contenido Iónico Extraíble	< 10 ppm valor típico
T _G , °C	55 valor típico
CTE _{UM} /(M°C) antes de T _G	47 valor típico
CTE _{UM} /(M°C) después de T _G	165 valor típico

MANEJO Y ALMACENAJE

Parámetro	Tiempo	Temperatura
Vida útil congelado	6 meses	< 0°C (32°F)
Vida útil en refrigeración	1 mes	0°C-12°C (32°F-54°F)
Vida útil sin refrigeración	1 semana	< 25°C (77°F)

No almacenar cerca de fuentes de calor, fuego o flama. Manténgase alejado de la luz solar ya que puede degradar el producto.

APLICACION

Para obtener resultados óptimos, se recomienda que el sustrato de la aplicación debe ser precalentado a 40°C-50°C (100°F-120°F). Aunque no se requiere, la boquilla dispensadora puede precalentarse para disminuir la viscosidad y aumentar la velocidad del flujo. La presión del sistema debe ser de 1-2.75 bares (15-40 psi). Se recomienda una velocidad de dispensado de 0,25 a 1,25 cm / s. (0,10 - 0,50 pulgadas / seg.). Se recomienda una distancia de dispensado de 0,025-0,075 mm (1-3 mils) por encima de la superficie del sustrato y 0,025-0,075 mm (1-3 mils) desplazada desde el borde del componente. Esto garantizará la máxima consistencia en el flujo y llenado. Se recomienda un patrón de dispensado para aplicaciones de dispensado por tornillo sin fin que sea de 0,65 mm (1/4 ") por un solo lado o solo una esquina, sin necesidad de un dispensado secundario ni de perímetro. La baja viscosidad y las excelentes características de humectación de este producto permiten que el material se "auto-encaje" a lo largo del borde opuesto del componente. El material se puede reparar o retocar a 120°C (250°F).

Parametro	Tiempo
Tiempo de Curado a 100°C (210°F)	8-10 minutos
Tiempo de Curado a 125°C (260°F)	4-5 minutos
Tiempo de Curado a 150°C (300°F)	1-2 minutos

*Temperatura máxima de curado 150°C (300°F).

SEGURIDAD

Usar con ventilación adecuada y equipo de protección personal adecuado. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad correspondiente para obtener información específica sobre emergencias. No deseché los materiales peligrosos en recipientes no aprobados.